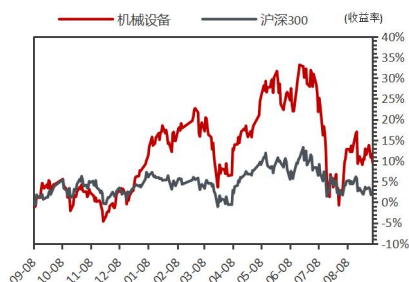


行业及产业

机械设备

强于大市

一年内行业指数与沪深 300 指数对比走势:



资料来源: 聚源数据

相关研究

《芯碁微装 (688630.SH) 2026 半年报点评: 高端 PCB 设备放量, 先进封装业务加速突破》2026-08-28

《光通信设备行业点评: 东山精密追加光电投资, 看好光设备景气上行》2026-08-24

《天准科技(688003.SH)2026 半年报点评: AI 链精密装备整装待发, 具身智能共驱成长》2026-08-21

《光通信设备行业点评: 英伟达 CPO 全面量产, 测试设备需求加速释放》2026-08-17

《PCB 设备行业点评: mSAP 扩产元年, 看好曝光、电镀环节设备增量机会》2026-08-10

证券分析师

王凯

S0820524120002

021-32229888-25522

wangkai526@ajzq.com

台积电设备采购预期上修, 看好半导体设备及零部件

——半导体设备行业点评

投资要点:

- **事件: AI 需求持续超预期, 台积电 2026 年设备采购数量持续上修。**9 月 2 日, 台积电资深副总经理暨副共同营运长侯永清在 SEMICON Taiwan 表示, 以 2025 年底对 2026 年设备采购数量预估 1X 为基准, 26Q1 已上调至 1.5X, 7 月进一步升至 1.9X; 目前台积电台湾同时建设 13 座晶圆厂, 海外另有 5-6 座, 全球接近 20 座晶圆厂同步推进, 但产能扩张仍难完全满足客户需求。我们认为, 台积电设备采购持续上修本质反映 AI 需求已加速转化为先进制程扩产及对应设备采购, 产业景气有望加速向半导体设备与零部件传导。
- **台积电全球扩产持续推进, 当前在建及规划晶圆厂接近 20 座, 仅已披露明确产能项目对应新增月产能有望超 30 万片, 考虑到美国后续项目, 实际规划产能则更高。**目前台积电全球在建及规划晶圆厂接近 20 座, 其中: **1) 中国台湾 13 座在建及规划晶圆厂:** 新竹 Fab 20 规划 4 期、高雄 Fab 22 规划 6 期, 均面向 2nm 及以下先进制程, 若按单期月产能约 2.5-3.0 万片测算, 两大基地合计 10 期, 对应新增月产能约 25-30 万片。同时, 台中 A14 规划 4 期, 台南基地继续扩充 N3 产能, 进一步承接先进制程需求。**2) 海外扩产同步加速, 美国为最主要的海外先进制程基地, 日本及德国则补充成熟及特色制程产能。**美国亚利桑那长期规划 6 座晶圆厂, 其中 Fab 2、Fab 3 分别向 3nm 及 2nm/A16 推进, 后续 Fab 4-6 预计继续扩充先进制程产能; 日本熊本 JASM 持续推进 Fab 2 建设, Fab1+Fab2 规划月产能约 10 万片; 德国德累斯顿 ESMC 规划月产能约 4 万片, 覆盖 28/22nm 及 16/12nm 制程。
- **晶圆厂扩产加速向设备及核心零部件环节传导, 设备订单增长、交期拉长与零部件在手订单高增共同验证产业链景气上行。**1) **设备端, 头部厂商收入、订单及产能规划持续上修, 部分设备交期明显延长。**泛林半导体 FY26Q4 实现营收 67.2 亿美元, 环比增长 15.1%, FY27Q1 营收指引中枢进一步提升至 81 亿美元; ASML FY26H1 订单流入保持强劲, 并计划于 FY2027 年将 Low-NA EUV 及浸没式 DUV 产能分别较上年提升约 30%。根据韩国媒体 ETNEWS 2026 年 7 月调研数据, 应用材料、ASML、泛林半导体、东京电子及 KLA 等主要设备厂商部分产品交期较此前延长至约 1.5-2 倍, 其中传统刻蚀、薄膜沉积设备交期由约 6 个月延长至约 12 个月。2) **零部件端, 设备厂订单增长及备货需求已逐步向上游核心供应商传导。**VAT FY26H1 订单额达 8.56 亿瑞士法郎, 同比增长 75%, 期末在手订单接近 6.5 亿瑞士法郎, 同比增长约 120%。随着设备厂商扩大生产、提前锁定供应及增加关键零部件备货, 上游采购需求同步增长。考虑核心零部件通常需提前于整机交付备货, 其订单变化具备一定前瞻性, 当前零部件订单高增表明晶圆厂扩产带来的需求已由设备端进一步向上游传导。
- **投资建议: 配置上, 建议围绕 AI 驱动下全球半导体资本开支扩张主线, 重点关注前道设备、核心零部件及先进封装设备。**台积电设备采购需求持续上修, 验证 AI 需求正加速传导至晶圆制造产能及对应设备投资, 并有望带动全球半导体设备景气持续向上。同时, 半导体设备需求亦进一步向核心零部件环节传导; 先进封装则受 AI 芯片复杂度提升及封装架构升级驱动, 持续贡献新增量。建议关注: **【晶圆制造设备】**海外设备链关注应用材料(AMAT.O)、Lam Research(LRCX.O)、KLA(KLAC.O); 国产设备链关注北方华创(002371.SZ)、中微公司(688012.SH)、拓荆科技(688072.SH)、微导纳米(688147.SH)、精测电子(300567.SZ)、精智达(688627.SH); **【设备零部件】**海外链关注 MKS(MKSI.O); 国产零部件链关注先锋精科(688605.SH)、新莱应材(300260.SZ); **【先进封装设备】**关注芯碁微装(688630.SH、09630.HK)、盛美上海(688082.SH)。
- **风险提示:** AI 算力投资及终端需求不及预期; 全球晶圆厂扩产节奏低于预期; 半导体设备厂商订单增长低于预期; 核心零部件国产替代进程及客户导入不及预期。

爱建证券有限责任公司

上海市浦东新区前滩大道 199 弄 5 号

电话: 021-32229888

传真: 021-68728700

服务热线: 956021

邮政编码: 200124

邮箱: ajzq@ajzq.com

网址: <http://www.ajzq.com>

评级说明

投资建议的评级标准

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即以报告发布日后的 6 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场：沪深 300 指数（000300.SH）；新三板市场：三板成指（899001.CSI）（针对协议转让标的）或三板做市指数（899002.CSI）（针对做市转让标的）；北交所市场：北证 50 指数（899050.BJ）；香港市场：恒生指数（HIS.HI）；美国市场：标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）。

股票评级

买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5% ~ 15%之间
持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 -5% ~ 5%之间
卖出	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于 -5%

行业评级

强于大市	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
弱于大市	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告采用信息和数据来自公开、合规渠道，所表述的观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的独立看法。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法可能存在局限性，请谨慎参考。

法律主体声明

本报告由爱建证券有限责任公司（以下统称为“爱建证券”）证券研究所制作，爱建证券具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管。

本报告是机密的，仅供我们的签约客户使用，爱建证券不因收件人收到本报告而视其为爱建证券的签约客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但爱建证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供签约客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，爱建证券及其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测后续可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，爱建证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

版权声明

本报告版权归爱建证券所有，未经爱建证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。版权所有，违者必究。